

附件 1

享受税收优惠政策的企业条件和项目标准

一、《若干政策》第（一）条提及的国家鼓励的集成电路线宽小于 28 纳米（含）、线宽小于 65 纳米（含）、线宽小于 130 纳米（含）的集成电路生产企业或项目享受税收优惠政策条件如下：

（一）在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法注册并具有独立法人资格的企业；

（二）符合国家布局规划和产业政策；

（三）汇算清缴年度，具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系，其中具有本科及以上学历月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不低于 30%，研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不低于 20%（从事 8 英寸及以下集成电路生产的不低于 15%）；

（四）企业拥有关键核心技术和属于本企业的知识产权，并以此为基础开展经营活动，且汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入（主营业务收入与其他业务收入之和）总额的比例不低于 2%（本条及下述研究开发费用政策口径，按照财税〔2015〕119 号和《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（2017 年第 40 号）的规定执行）；

（五）汇算清缴年度集成电路制造销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于 60%；

(六) 具有保证相关工艺线宽产品生产的手段和能力；

(七) 汇算清缴年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为；

(八) 对于按照集成电路生产项目享受税收优惠政策的，项目主体企业应符合相应的集成电路生产企业条件，且能够对该项目单独进行会计核算、计算所得，并合理分摊期间费用。

二、《若干政策》第（三）、（七）条提及的国家鼓励的重点集成电路设计企业享受税收优惠政策条件，除符合《若干政策》第（二）条所称国家鼓励的集成电路设计企业条件外，还应符合以下条件：

(一) 汇算清缴年度具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系，其中具有本科及以上学历月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不低于 50%，研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不低于 40%；

(二) 拥有关键核心技术，并以此为基础开展经营活动，且汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入（主营业务收入与其他业务收入之和）总额的比例不低于 6%；

(三) 汇算清缴年度集成电路设计（含 EDA 工具、IP 和设计服务，下同）销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于 70%，其中集成电路自主设计销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于 60%；对于集成电路设计销售（营业）收入超过 50 亿元的企业，汇算清缴年度集成电路设计销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于 60%，其中集成电路自主设计销售

(营业)收入占企业收入总额的比例不低于 50%;

(四)企业拥有核心关键技术和属于本企业的知识产权,企业拥有与集成电路产品设计相关的已授权发明专利、布图设计登记、计算机软件著作权合计不少于 8 个;

除以上条件外,还应至少符合下列条件中的一项:

(一)汇算清缴年度,集成电路设计销售(营业)收入不低于 5 亿元,应纳税所得额不低于 3000 万元;对于集成电路设计销售(营业)收入不低于 50 亿元的企业,可不要求应纳税所得额,但研究开发费用总额占企业销售(营业)收入(主营业务收入与其他业务收入之和)总额的比例不低于 8%。

(二)在国家鼓励的重点集成电路设计领域内(附件 2),汇算清缴年度集成电路设计销售(营业)收入不低于 3000 万元,应纳税所得额不低于 350 万元。

三、《若干政策》第(三)、(七)条提及的国家鼓励的重点软件企业,除符合国家鼓励的软件企业条件外,还应至少符合下列条件中的一项,具体领域说明见附件 2。

(一)专业开发基础软件、研发设计类工业软件的企业,汇算清缴年度软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入(其中相关信息技术服务是指实现软件产品功能直接相关的咨询设计、软件运维、数据服务,下同)不低于 5000 万元;汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不低于 7%。

(二)专业开发生产控制类工业软件、新兴技术软件、信息

安全软件的企业，汇算清缴年度软件产品销售及相关信息技术服务（营业）收入不低于 1 亿元；应纳税所得额不低于 500 万元；研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不低于 30%；汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 8%。

（三）专业开发重点领域应用软件、经营管理类工业软件、公有云服务软件、嵌入式软件的企业，汇算清缴年度软件产品销售及相关信息技术服务（营业）收入不低于 5 亿元，应纳税所得额不低于 2500 万元；研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不低于 30%；汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 7%。

四、《若干政策》第（六）条提及的集成电路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业、线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业、集成电路线宽小于 0.5 微米（含）的化合物集成电路生产企业，以及财关税〔2021〕4 号文提及的集成电路产业的关键原材料、零配件（靶材、光刻胶、掩模版、封装基板、抛光垫、抛光液、8 英寸及以上硅单晶、8 英寸及以上硅片）生产企业享受税收优惠政策条件如下：

（一）在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法注册并具有独立法人资格的企业；

（二）符合国家布局规划和产业政策；

（三）具有保证产品生产的手段和能力；

（四）汇算清缴年度未发生重大安全、重大质量事故或严重

环境违法行为。

五、《若干政策》第（六）条提及的先进封装测试企业享受财税优惠政策条件如下：

（一）在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法注册并具有独立法人资格的企业；

（二）符合国家布局规划和产业政策；

（三）汇算清缴年度企业先进封装测试（晶圆级封装、系统级封装、2.5 维和 3 维封装）规划产能占总规划产能比例，按封装产品颗粒数或晶圆数（折合 8 英寸）计算不低于 40%；

（四）具有保证产品生产的手段和能力；

（五）汇算清缴年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

六、《若干政策》第（八）条提及的集成电路重大项目企业享受财税优惠政策条件如下：

享受《若干政策》第（八）条的集成电路重大项目承建企业应符合本通知第四、五条的相对应规定。除以上条件外，还应符合下列对应条件中的一项：

（一）芯片制造类重大项目，需同时满足以下条件：

1.符合国家布局规划和产业政策；

2.对于不同工艺类型芯片制造项目，需分别满足以下条件：

（1）对于工艺线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器项目，固定资产投资总额需超过 80 亿元，规划月产能超过 1 万片（折合 12 英寸）。

(2) 对于工艺线宽小于 0.25 微米 (含) 的模拟、数模混合、高压、射频、功率、光电集成、图像传感、微机电系统、绝缘体上硅工艺等特色芯片制造项目, 固定资产投资额超过 10 亿元, 规划月产能超过 1 万片 (折合 8 英寸)。

(3) 对于工艺线宽小于 0.5 微米 (含) 的基于化合物集成电路制造项目, 固定资产投资额超过 10 亿元, 规划月产能超过 1 万片 (折合 6 英寸)。

(二) 先进封装测试类重大项目, 需同时满足以下条件:

1. 符合国家布局规划和产业政策;
2. 固定资产投资额超过 10 亿元;
3. 封装规划年产能超过 10 亿颗芯片或 50 万片晶圆 (折合 8 英寸)。